

Embedded Technology 2016 /組込み総合技術展 『電子設計-EDA ゾーン』 出展参加申込みについて

11月16日(水)～18日(金)に開催いたします、組込みシステム技術関連のイベント、Embedded Technology 2016 では、電子設計-EDA ゾーンを設置いたします。組込みシステムや IoT のエッジデバイス、ゲートウェイを支える要素技術として、半導体は欠かせません。センサーや MEMS を含むアナログ技術、コネクテッドデバイスに必須の RF 技術、ビルディングブロック構成を支える IP、LSI・パッケージ・ボード (LPB) 協調設計技術、設計工程の多くを自動化する EDA 技術や FPGA プロトタイプなど、より複雑で付加価値の高い半導体を創る、使う、使いこなす能力は、真の差別化には不可欠です。このゾーンはまさにそのような要素技術を展望する出展者と、設計課題を克服し新たな製品に向けたヒントを得ようとする技術者の双方の視点にたった場を提供するものです。昨年に続き、LPB バビリオンも設置する予定です。また、関連する設計者にも広く告知を行って、出展社と来場者のマッチングを行って参ります。是非ともこの機会をご利用いただきたく、皆様の積極的なご出展をお待ちしております。

【キーワード】 LSI、IP、FPGA、FPGA プロトタイプ、アナログ、メモリ、パッケージ、SERDES、EDA、
受託設計、検証サービス、ノイズ解析

※出展申込については、添付の出展申込書に必要事項を記入の上、事務局へ **6月30日(木)**までにお申込みください。

【出展料金】

通常ブース(3m×3m=9㎡)

※出展スペースのみの料金となります。装飾については別途手配が必要となります。

単列小間(1～3小間)	一般: 464,400円(税込)	会員: 410,400円(税込)
複列小間(4小間以上)	一般: 442,800円(税込)	会員: 388,800円(税込)
※会員とは一般社団法人 組込みシステム技術協会の会員企業を指します。		

●小間仕様

- 他社の出展スペースと隣接する場合は、接続面に基礎壁面を設置いたします。
- 10小間以上は単独の島小間となり壁面は設置されません。

<参考>通常出展パッケージブース(有料)

事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低コストのパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。皆様の出展のご検討とあわせまして、出展費用算出のご参考としてご確認ください。

スタンダードプラン 1小間(3m×3m 高さ2.7m)

セット価格: ¥108,000(税込)



- パラベット 一式
- パンチカーペット 9㎡
- 社名サイン 一式
- 蛍光灯40W 2灯
- パイプイス 1脚
- 受付カウンター 1台
- 展示台2890×495×900 一式
- アーム付スポットライト100W 3灯
- 2口コンセント(500W) 1個
- 一時側幹線工事費用 1KW

※上記の他にも小間数に応じた多様なデザインをご用意しております。

特設ブース 1 小間(2m×2m)

出展スペースとパッケージ装飾がセットとなります。

※料金にパッケージ装飾が含まれている為、特別装飾は出来ませんのでご注意ください。

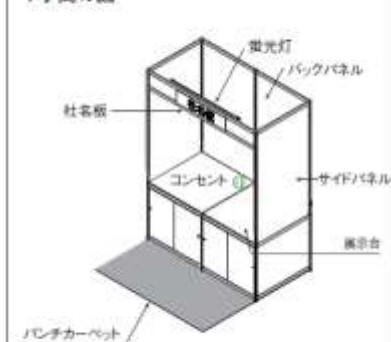
一般: **259,200**円(税込) 会員: **216,000**円(税込)

※会員とは一般社団法人 組込みシステム技術協会の会員企業を指します。
 ※変則形状(四辺形以外)は原則としてお受けできません。

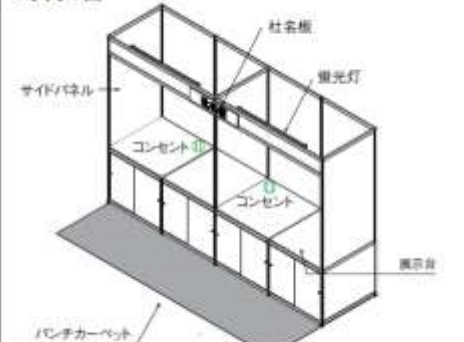
●小間仕様

- 出展スペース
- サイドパネル・バックパネル
- 展示台
(W:1,970mm×D:1,000mm×H:900mm)
- スライドドア付
- 社名板表示(黒文字・角ゴシック体)
- 電源工事
(2口コンセント(100V/500W)×1カ所)
※電気使用料含む
- 蛍光灯
- パンチカーペット

1 小間の図



2 小間の図



【出展申込〆切】 2016 年 6 月 30 日(木)

<お申込・お問合せ先>

Embedded Technology/IoT Technology 事務局
 〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
 Tel: 03-5657-0756 Fax: 03-5657-0645
 E-mail: etinfo@jasa.or.jp

ET/IoT Technology 公式ウェブサイト: <http://www.jasa.or.jp/expo/>